

## 锦州神工半导体股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 18 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司 2022 年年度报告》（以下简称“2022 年年度报告”）。经事后审核及公司自查，发现年报部分内容有误，现对部分内容进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司 2022 年度财务状况及经营成果产生影响。

### 一、更正的内容

1、对《2022 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2. 收入和成本分析”之“（2）. 产销量情况分析表”之“产销量情况说明”进行更正：

#### 更正前：

在大直径硅材料方面，除了国内外市场需求旺盛，公司抓住刻蚀机零部件大型化趋势，加大研发力度，16 英寸以上产品产销量增加较多。在硅零部件、硅片等方面，除了给客户认证使用的免费样品以外，销售额与去年相比呈现大幅度上升。表明了零部件、硅片等产品逐步通过客户认证，获得的批量订单增加。

#### 更正后：

在大直径硅材料方面，除了国内外市场需求旺盛，公司抓住刻蚀机零部件大型化趋势，加大研发力度，16 英寸以上产品销量稳中有升。在硅零部件、硅片

等方面，除了给客户认证使用的免费样品以外，销售额与去年相比呈现大幅度上升。表明了硅零部件、硅片等产品逐步通过客户认证，获得的批量订单增加。

2、《2022年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“(1).按账龄披露”

更正前：

适用 不适用

更正后：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	102,892,768.66
1年以内小计	102,892,768.66
1至2年	143,006.95
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	103,035,775.61

3、《2022年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“(2).按坏账计提方法分类披露”之“按组合计提坏账准备”

更正前：

组合计提项目：其中：组合1应收海外客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
其中：组合1应收海外客户	51,710,179.46	1,737,335.41	3.36
合计	51,710,179.46	1,737,335.41	3.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 应收国内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2 应收国内客户	51,325,596.15	2,954,241.66	5.76
合计	51,325,596.15	2,954,241.66	5.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

**更正后：**

组合计提项目：其中：组合 1 应收海外客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	38,216,105.23	382,161.05	1.00
逾期 0 至 90 天	13,436,404.90	1,343,640.49	10.00
逾期 90 天至 1 年	57,669.33	11,533.87	20.00
合计	51,710,179.46	1,737,335.41	3.36

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 应收国内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	24,370,873.70	243,708.74	1.00
逾期 1 年以内	26,804,115.50	2,680,411.53	10.00
逾期 1 至 2 年	150,606.95	30,121.39	20.00
合计	51,325,596.15	2,954,241.66	5.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

4、《2022 年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“其他应收款”之“(1). 按账龄披露”

**更正前：**

适用 不适用

**更正后：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	186,254.41
1年以内小计	186,254.41
1至2年	783,000.00
2至3年	63,452.60
3年以上	2,500.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	1,035,207.01

5、《2022年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款”之“其他应收款”之“(4). 坏账准备的情况”

更正前：

□适用 √不适用

更正后：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	8,498.49	1,853.58				10,352.07
合计	8,498.49	1,853.58				10,352.07

6、《2022年年度报告》“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款”之“(1). 按账龄披露”

更正前：

□适用 √不适用

更正后：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	88,271,613.62
1年以内小计	88,271,613.62
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	88,271,613.62

7、《2022年年度报告》“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款”之“(2).按坏账计提方法分类披露”之“按组合计提坏账准备”

更正前：

适用 不适用

更正后：

适用 不适用

组合计提项目：组合1 应收海外客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	38,022,837.58	380,228.38	1.00
逾期0至90天	13,436,404.90	1,343,640.49	10.00
逾期90天至1年	2.44	0.49	20.00
合计	51,459,244.92	1,723,869.36	3.35

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合2 应收国内客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	10,194,168.85	101,941.69	1.00
逾期1年以内	25,304,164.85	2,530,416.47	10.00

逾期 1 至 2 年			
合计	35,498,333.70	2,632,358.16	7.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3 应收关联方客户（合并范围内）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合 3 应收关联方客户（合并范围内）	1,314,035.00		
合计	1,314,035.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

8、《2022 年年度报告》“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款”之“(3). 坏账准备的情况”

更正前：

适用 不适用

更正后：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,355,904.43	3,000,323.09				4,356,227.52
其中：组合 1 应收海外客户	999,749.43	724,119.93				1,723,869.36
组合 2 应收国内客户	356,155.00	2,276,203.16				2,632,358.16
组合 3 应收关联方客户（合并范围内）						
合计	1,355,904.43	3,000,323.09				4,356,227.52

9、《2022 年年度报告》“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收账款”之“其他应收款”之“(1). 按账龄披露”

更正前：

适用 不适用

更正后：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	183,854.41
1 年以内小计	183,854.41
1 至 2 年	783,000.00
2 至 3 年	4,000.00
3 年以上	2,500.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	973,354.41

## 二、其他说明

除上述更正内容外，《2022 年年度报告》其他内容保持不变，更正后的《2022 年年度报告》将与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日